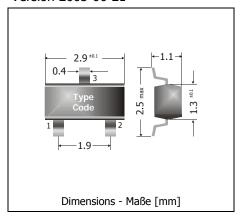


BAS40, BAS40-04, BAS40-05, BAS40-06

Surface Mount Schottky Barrier Single/Double Diodes Schottky-Barrier Einzel-/Doppel-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2005-06-21



Power dissipation – Verlustleistung 310 mW

Repetitive peak reverse voltage 40 V

Periodische Spitzensperrspannung

Plastic case SOT-23

Kunststoffgehäuse (TO-236)

Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Weight approx. - Gewicht ca.



0.01 g

Maximum ratings $(T_A = 25^{\circ}C)$

Grenzwerte ($T_A = 25$ °C)

per diode / pro Diode		BAS40-series	
Power dissipation – Verlustleistung ¹)	P _{tot}	310 mW ²)	
Max. average forward current (dc) Dauergrenzstrom	I _{FAV}	200 mA ²)	
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	300 mA ²)	
Non repetitive peak forward surge current $t_p \le 1 \text{ s}$ Stoßstrom-Grenzwert	\mathbf{I}_{FSM}	0.6 A	
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	40 V	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _j T _S	-55+150°C -55+150°C	

Characteristics $(T_i = 25^{\circ}C)$

Kennwerte ($T_j = 25$ °C)

			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Forward voltage ³) Durchlass-Spannung ³)	$\begin{array}{l} I_{\text{F}}=1 \text{ mA} \\ I_{\text{F}}=10 \text{ mA} \\ I_{\text{F}}=40 \text{ mA} \end{array}$	V _F V _F	< 380 mV < 500 mV < 1.00 V
Leakage current Sperrstrom	$V_R = 30 V$ $V_R = 40 V$	$\begin{matrix} I_{R} \\ I_{R} \end{matrix}$	< 200 nA < 10 μA
Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität $V_{\text{R}}=0\ \text{V, f}=1\ \text{MHz}$		C _T	5 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug $I_{\text{F}} = 10$ mA über/through $I_{\text{R}} = 10$ mA bis/to $I_{\text{R}} = 1$ mA		t _{rr}	< 5 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R _{thA}	< 400 K/W ²)

¹ Total power dissipation of both diodes – Summe der Verlustleistungen beider Dioden

² Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

³ Tested with pulses tp = 300 µs, duty cycle ≤ 2% — Gemessen mit Impulsen tp = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%



Pinning – Anschlussbelegung		Marking – Stempelung
1 2	Single Diode Einzeldiode 1 = A 2 = n.c./frei 3 = C	BAS40 = 43
1 2	Dual diode, series connection Doppeldiode, Reihenschaltung 1 = A1 2 = C2 3 = C1/A2	BAS40-04 = 44
1 2	Dual diode, common cathode Doppeldiode, gemeinsame Katode 1 = A1 2 = A2 3 = C1/C2	BAS40-05 = 45
1 2	Dual diode, common anode Doppeldiode, gemeinsame Anode 1 = C1 2 = C2 3 = A1/A2	BAS40-06 = 46

